

P.C.B ディスコネクト 1.47mm DIA ピンリセプタクル 納入仕様書

1 適用範囲

1.1 本仕様書は、カシオ計算機株式会社に納入するアンプディスコネクト 1.47mm DIA ピン、60809-1、リセプタクル；P/N 60598-1について規定する。

1.2 適用プリント基板

P/N	穴径 (mm)	厚さ (mm)
60809-1	1.47~1.57	1.6~2.4

1.3 適用電線

P/N	電線サイズ (mm)	被覆外径 (mm)
60598-1	0.20~0.56	1.14~1.78

1.4 定格電流 3A以下

2 適用規格

本製品は下記の規格の指定するものによる。

2.1 材料及び表面処理

製品図面に規定する錫めつき済黄銅及びりん青銅。

2.2 形状及び構造

製品図面に規定する。

3 性能

3.1 圧着及び接触部電気抵抗

第3.1.1項に規定する試験方法により電気抵抗は14mΩ以下のこと。

3.1.1 試験方法

第1図の如く、ピンをプリント基板に固着し、リセプタクルを嵌合した状態で回路電圧D.C.50mV、50mAで測定する。

3.2 圧着部引張り強度

第3.2.1項に規定する試験方法により圧着部引張り強度は下記に示す値以上のこと。

PRINT DIST					DR	AMP	AMP (Japan), Ltd.	
					CHK		TOKYO, JAPAN	
					APP		LOC	REV
							J	0
	0 Released	U.H.	2/13	SHEET 1 OF 4		P.C.B ディスコネクト 1.47mm DIA ピン、リセプタクル納入仕様書		
	LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE			

電線サイズ (AWG)	引張り強度 (kg)
0.20 (#24)	3.0以上
0.33 (#22)	5.0以上
0.52 (#20)	8.0以上

3.2.1 試験方法

第2図の如くリセプタクルと電線との間に垂直方向の荷重を25.4mm/分の速さで加える。

3.3 嵌合力及び離脱力

第3.3.1項に規定する試験方法により嵌合力は5kg以下、離脱力は0.5kg以上のこと。

3.3.1 試験方法

第3図の如く、ピンをプリント基板に固着し、リセプタクルを25.4mm/分の速さで垂直方向に3回嵌合離脱を行ない4回目を測定記録すること。

3.4 振動

振動は第3.4.1項に規定する試験方法により 5×10^{-4} (秒)以上の接触不良状態が生じないこと。

3.4.1 試験方法

振動周波数: 500 Cycle/秒、振動力: 5G

振動方向: X(前後) Y(左右) Z(上下)の3方向

試験時間はX、Y、Z各1時間計3時間行う。また回路電流は100mAで測定する。

3.5 塩水噴霧試験

第3.5.1項に規定する試験方法により試験後接触抵抗は14mΩ以下、また外観に損傷のないこと。

3.5.1 試験方法

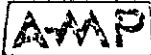
MIL-STD-202方法101B、条件Bによる。

3.6 温度サイクル試験

第3.6.1項に規定する試験方法により試験後、接触抵抗は14mΩ以下また外観に損傷のないこと。

3.6.1 試験方法

MIL-STD-202、方法102A、条件Cによる。

SHEET				AMP (Japan), Ltd TOKYO, JAPAN	
2 OF 4	LOC J	A	NS 108-5034-1	REV 0	
NAME P.C.B デイスコネクト 1.47mm DIA ピン、リセ プタクル納入仕様書					

3.7 耐久性試験

第3.7.1項に規定する試験方法により100回試験後接触抵抗は $14\text{ m}\Omega$ 以下、嵌合力は5kg以下、離脱力は0.5kg以上、また外観に損傷のないこと。

3.7.1 試験方法

第3図の如くピンをプリント基板に固着し、10回/分以下の速度で100回嵌合離脱を行なうこと。

3.8 はんだ付性

3.8.1 はんだ付性試験

3.8.1.1 はんだ槽温度 $250 \pm 5^\circ\text{C}$

3.8.1.2 はんだ 錫60% 鉛40%

3.8.1.3 フラックス浸漬時間 約5~10(秒)

3.8.1.4 はんだ浸漬時間 約3(秒)

3.8.1.5 端子をプリント板に垂直に立てて、はんだ付けする際フラックスおよびはんだの付着位置は端子先端より最大約4.5mm点の位置迄とする。

3.8.1.6 検査: 拡大倍率10倍の拡大レンズで検査して、浸漬面積の90%以上の部分がおおわれていること、また、ピンホール、空けき、あるいは粗点が1個所に集中してなく、全面積の10%をこえていないこと。

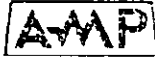
3.9 環境条件

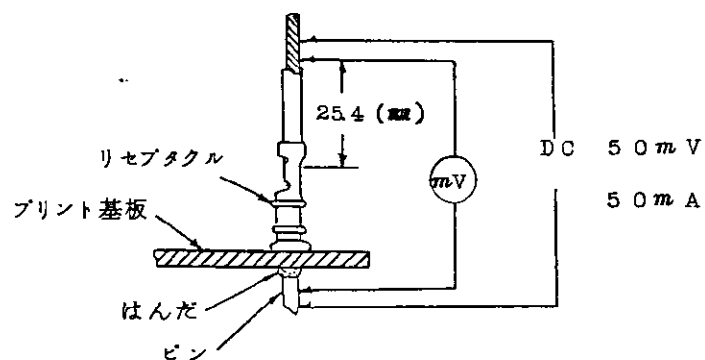
下記の条件のもとで性能試験を行うこととする。

室温: $20 \sim 30^\circ\text{C}$

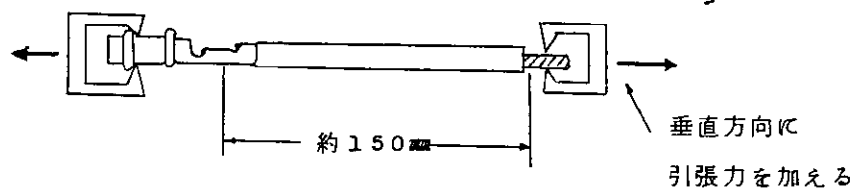
湿度: 50~80%

気圧: $610 \sim 790\text{ mmHg}$

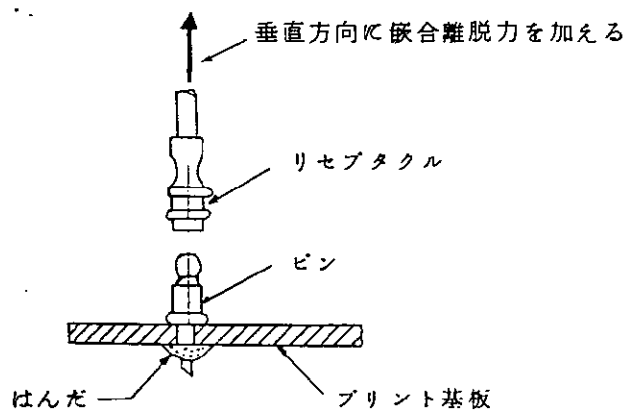
SHEET				AMP (Japan), Ltd TOKYO, JAPAN
3 OF 4	LOC J	A	NO 108-5034-1	REV 0
NAME P.C.B ディスコネクト147mm DIA ピン・リセブ タクル納入仕様書				



第 1 図



第 2 図



第 3 図

SHEET		AMP		AMP (Japan), Ltd TOKYO, JAPAN	
4 OF 4		LOC J	A	NO 108-5043-1	REV O
NAME P.C.B ディスコネクト 1.47mm DIA ピン・リセ プタクル納入仕様書					